

KPMG

毕马威

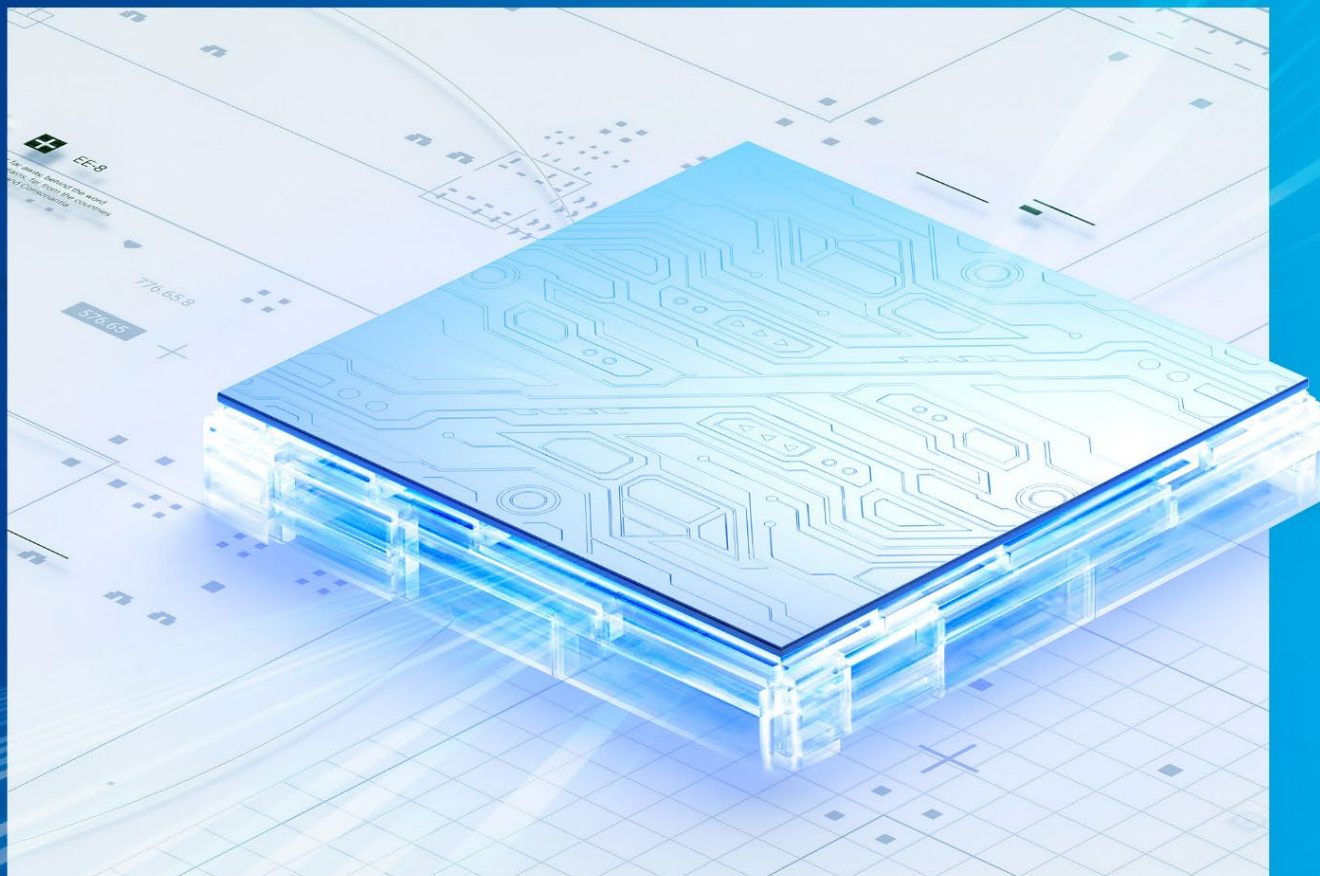
中国“芯科技” 新锐企业50报告(第五届)



未来行业50
Future Sector 50



芯科技
ChipTech



毕马威中国
kpmg.com/cn

关于毕马威

毕马威中国在三十一个城市设有办事机构，合伙人及员工超过14,000名，分布在北京、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、佛山、福州、广州、海口、杭州、合肥、济南、南京、南通、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、太原、天津、武汉、无锡、厦门、西安、郑州、香港特别行政区和澳门特别行政区。在这些办事机构紧密合作下，毕马威中国能够高效和迅速地调动各方面的资源，为客户提供高质量的服务。

毕马威是一个由独立的专业成员所组成的全球性组织，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威国际有限公司（“毕马威国际”）的成员所以毕马威为品牌开展业务运营，并提供专业服务。“毕马威”可以指毕马威全球性组织内的独立成员所，也可以指一家或多家毕马威成员所。

毕马威成员所遍布全球143个国家及地区，拥有超过273,000名专业人员。各成员所均为各自独立的法律主体，其对自身描述亦是如此。各毕马威成员所独立承担自身义务与责任。

毕马威国际有限公司是一家英国私营担保有限责任公司。毕马威国际及其关联实体不提供任何客户服务。

1992年，毕马威在中国内地成为首家获准开业的中外合作会计师事务所。2012年8月1日，毕马威成为四大会计师事务所之中首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入市场的先机以及对质量的不懈追求，使我们积累了丰富的行业经验，中国多家知名企业长期聘请毕马威提供广泛领域的专业服务（包括审计、税务和咨询），也反映了毕马威的领导地位。

免责声明

本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。

本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含信息的准确性不作保证。除前述免责声明外，毕马威亦不承担本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和 / 或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害，包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。

倘若本免责声明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。

目录

卷首语	01
毕马威中国“未来 50”系列榜单	03
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 介绍	04
毕马威中国半导体行业系列活动	05
毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单	06
半导体行业发展趋势	07
附件	12
附件一 半导体行业政策法规更新	12
附件二 毕马威中国“芯科技”50 评选团队	15
附件三 毕马威半导体行业洞察	16

卷首语



杨洁

毕马威中国副主席
毕马威中国
华东及华西区
首席合伙人

半导体行业是现代信息技术产业的核心，对于推动经济发展和科技进步具有重要意义。在2019年的进博会上，毕马威中国启动了第一届“‘芯科技’新锐企业 50”评选活动，深度洞见芯片领域的前沿态势，把脉半导体行业的技术演进与创新。今年，第五届“‘芯科技’新锐企业 50”评选榜单如期而至，毕马威联合内外部多领域的专家进行调研和探讨，以公开、公正、公平的评价标准进行评估，旨在促进中国半导体领域的发展以及助力优质企业的成长。

我国政府高度重视半导体产业的发展，制定了一系列政策支持和鼓励国内企业加强研发，推动产业升级和技术创新。在国产替代的浪潮中，中国芯片产业正面临着前所未有的发展机遇。

半导体产业链的各环节均具备一定的门槛，需要持续的资金和人才投入，政策扶持对半导体产业发展推进的意义重大。目前，中国半导体行业的发展着重落在集成电路领域。“十四五”是中国半导体行业夯实基础、谋取更大进步的关键五年，多个“十四五”相关政策均将集成电路列入重点发展项目。

芯片短缺时代已经结束，以往过剩的存货目前已被消化，生成式AI和电动汽车等新技术将使芯片需求与供应保持同步。实际上，从2024年行业收入增长的预测结果看，芯片库存似乎没有令人特别担忧。汽车行业再次成为驱动行业收入增长的最重要应用。尽管2024年依然面对其中的一些挑战，但整体行业极具韧劲，市场不乏增长机遇。



陈俭德

毕马威中国
通信、媒体及科技行业
主管合伙人

近年来，得益于政策和市场的“双轮驱动”，我国半导体电子行业发展迅速，已经成为全球最大的半导体与集成电路市场。尽管如此，半导体电子制造企业在设计、制造等环节也正在面临一系列新挑战，亟需借助云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术的落地，加快企业数字化、智能化转型，实现降本增效，推动企业高质量发展。

目前，半导体电子行业的发展动力主要来自两个层面：一方面，汽车、工业、通讯及消费电子等传统领域加速转型，对半导体的总需求量大幅增加；另一方面，AI大模型、自动驾驶、元宇宙等新兴领域的崛起，也在激发大算力芯片性能持续迭代。

面对市场需求的不断涌现，我国半导体电子行业亟需加快转型升级步伐。其中，在研发层面，由于芯片规模持续翻番，企业不仅要保证核心研发设计软件、装备和材料供应的连续性，还要保障面对多批次、小批量给物料库存、齐套、准时交付与成本带来的研发资产信息安全；在产品创新层面，面对新材料带来的新挑战，企业需要借助数字化手段加速产品上市，并借助AI提升质检精度和效率；在柔性定制层面，企业需要从外观创新升级到功能与性能创新，以解决用户高频刚性需求。为此，半导体电子行业亟需加快人工智能等数字技术的落地应用，实现智能化升级。在此过程中，智能化浪潮不仅会给半导体电子行业带来新的机会，也将推动半导体电子行业自身的变革。



李吉鸣

毕马威中国
半导体行业
审计主管合伙人

2024年全球半导体市场展现出复苏的迹象，受到人工智能、新能源等新兴技术的推动，市场需求持续增长。中国在半导体设备投资方面表现尤为突出，成为全球最大半导体设备市场。然而，地缘政治紧张和人才短缺等问题仍然是行业发展的挑战。未来，随着技术进步和市场需求的不断扩大，半导体行业有望继续保持增长势头。

半导体行业的周期一直与需求和应用密不可分。在人工智能日益深入的大背景下，各行各业都对半导体的需求水涨船高，促进市场增长的同时，也推动了半导体技术的快速进步和迭代。所以，在需求倒逼的当下，半导体将延续增长的态势。

2024年全球半导体行业进入上行通道，去库存节奏落后的子板块逐渐迎来周期触底。下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力。同时，人才是持续性成为企业成功的关键要素，也是技术创新和产业持续发展的基础。近年来，尽管吸引了大量年轻人加入，但全球半导体行业仍面临人才短缺的挑战。

AI大模型的发展需要强大的算力支持，这也直接推动了高性能计算芯片的需求。同时，新能源汽车的快速发展也为半导体行业带来了新的增长点，特别是在电动汽车中使用的功率模块和芯片解决方案。AI相关应用的高景气度和汽车电子需求的强劲，推动了半导体市场的需求增长。此次毕马威中国携第五届“芯科技”50榜单再度归来，坚持以专业的服务和全球化的视野，为企业搭建并拓宽发展赛道。



毕马威中国 “未来 50” 系列榜单



不动产科技
PropTech



金融科技
Fintech



汽车科技
Autotech



生物科技
Biotech



文创科技
Culture Tech



芯科技
ChipTech



新能源科技
New Energy Tech



消费50
Consumer 50



医疗科技
Healthcare



智能制造科技
Smart Manufacturing Tech

在现今竞争激烈的全球化市场中，所有公司都经历着前所未有的转变。为了帮助企业洞察行业、看清未来，毕马威中国希望通过未来行业50榜单系列，为企业清晰呈现行业洞察，化洞察为机遇，协助客户解决在各自行业中面临的巨大挑战。毕马威与全球各行业顶尖公司合作，在审计、税务和咨询方面均拥有经验丰富且实力雄厚的行业团队，以专业视角洞察行业及市场，并凭借丰富项目经验为客户提供最优质的服务，助力企业洞察当下、把握未来。

商场如赛场，行业如赛道。毕马威中国推出涵盖金融、工业制造及汽车、生物、消费、芯片、医疗健康、文创、地产、政府及能源等行业的“未来行业50”榜单系列，旨在根据企业身处的不同生命周期，引导他们做出契合其发展的战略选择，并帮助行业及资本遴选未来赛道上的明星企业。同时，毕马威

提出以“未来行业50赛道”的概念，持续为企业搭建并拓宽各行业赛道。

自推出以来，毕马威“未来行业50”榜单系列始终坚持以专业性、公平性和平台性为三大特点，不断扩大各行业网络的内外部连接，并最终增加行业生态系统的整体价值。评选过程由毕马威联合内外部专家共同组成评选委员会，从团队、技术、产品、市场、融资等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对企业进行评估。

我们希望毕马威“未来行业50”榜单系列成为这样一个提供行业赛道的平台，为企业带来更多的市场机遇，持续助力行业创新变革，共同揭示行业深刻洞察，预见行业未来。

毕马威中国“芯科技” 新锐企业 50 介绍

毕马威作为拥有全球网络的专业服务机构，持续深耕科技行业。我们观察到技术演进在中国芯片领域正带来更多的模式创新和技术创新。

为促进中国芯片领域的发展以及为该领域内企业的成长提供支持，继 2020 年发布首届毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 评选后，毕马威中国设立“芯科技”新锐企业 50 榜单，至今已开启五届评选活动。

毕马威“芯科技”新锐企业 50 榜单，针对中国芯片领域内致力于推进通信终端及网络、感知系统、数字处理及逻辑运用、物联网实体应用、半导体材料

以及半导体设备及零部件的高成长企业，通过线上模型和线下专家团队综合评选机制，评选优质创业企业。

此外，为了加强对创业企业的支持，降低规模及资本对评选结果的影响，本次评选暂不考虑已经上市的公司。

本次评选不收取任何费用。

注：

我们推出中国“芯科技”新锐企业评选活动，旨在加强市场对芯片科技领域技术创新的关注，推动行业交流，促进芯片科技的良性发展，并非对参评企业合规性与可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读。本次评选不收取任何费用，特此说明。

评委会组成

我们的评审委员会由多领域专家组成，包括：毕马威行业专家及合伙人、中国芯片领域领军企业、半导体协会、人工智能行业联盟及科研领域的专家学者等。

评选过程

评委实地访谈、调研备选企业，更全面、翔实地掌握了第一手资料，确保榜单的客观、公正和严谨。



参选条件

- 企业在中国芯片领域具有创新性，包括以下六个维度：
 - 通信终端及网络
 - 感知系统
 - 数字处理及逻辑运用
 - 物联网实体运用
 - 半导体材料
 - 半导体设备及零部件
- 持续经营 12 个月及以上
- 非上市公司

核心评价维度

- 技术和商业模式的创新
- 估值与资本市场认可
- 半导体行业协会认可度
- 市场认可度
- 财务健康状况
- 团队能力

评选方法

1. 案头调研 (Desktop research)

基于毕马威对芯片设计行业的长期观察，提炼该行业的生态现状

2. 实地访谈 (Field interview)

毕马威中国“芯科技”50 团队对报名企业进行实地走访，访谈企业创始人及高管团队

3. 专家访谈 (Experts interview)

通过对行业领军企业的高管、科研领域的专家学者等业内专家进行访谈，听取业内人士对行业及细分领域的认知与见解

4. 数据模型分析 (Data analysis)

采用毕马威自主开发的创业企业洞察力模型 SIP，对企业进行评估

毕马威中国 半导体行业系列活动

毕马威中国的半导体行业小组是四大会计师事务所中唯一实现审计、税务、咨询一体化的半导体行业专项小组。该小组由各业务部门中具备丰富半导体行业服务经验的精英专家组成，小组成员遍布全国各主要城市，以便在必要时向客户提供目标明确的行业经验和专业建议。这些专家在半导体行业中拥有深厚的专业知识和实践经验，能够准确把握市场动态和客户需求，为客户提供个性化的解决方案，能够为企业、基金投资、园区创立发展的全生命周期提供相关解决方案，与客户共同成长。

过去一年里，我们举办了多场主题交流会，邀请行业内的专家、学者和企业代表分享最新的技术、市场趋势和业务经验。同时我们积极参与各类论坛和行业峰会，与行业精英、专家学者和企业代表进行深入的交流和探讨。通过这些活动，我们能够及时获取最新的行业信息和发展动态，拓宽视野，提升专业素养和服务水平。我们积极分享我们的专业知识和经验，与业界同行共同探讨半导体行业的未来发展趋势和挑战。

芯科技50评选



2024年1月资本市场两地上市研讨会



港交所18C规则研讨会 - 上海场



2022年11月
某汽车半导体峰会



2022年11月解读
“全球半导体行业展望”



2023年4月集成电路
供应链相关培训会



2023年7月
PE专题培训

毕马威中国“芯科技” 新锐企业 50 榜单

企业简称	企业简称	企业简称
昂迈微	纳生微	芯启源
爱仕特	鹏瞰半导体	芯率智能
爱芯元智	普能微电子	芯易荟
翠展微电子	苹芯科技	曦智科技
滴翠智能	清纯半导体	芯炽科技
光鉴科技	深迪半导体	旋智科技
红与蓝微电子	赛勒科技	云德材料
瑜捷电子	舜铭存储	隐冠半导体
精控集成半导体	时擎科技	英韧科技
聚时科技	图灵量子	奕泰微电子
硅酷科技	他山科技	忆芯科技
KiwiMoore	矽安光电	涌现科技
奎芯科技	芯驰科技	亿铸科技
酷芯微电子	芯璐科技	泽丰
凌锐半导体	芯来科技	肇观电子
弥费科技	星逻智能	源展材料

* 以上名单按照企业简称首字母顺序排序，排名不分先后。

注：我们推出中国“芯科技”新锐企业评选活动，旨在加强市场对芯片科技领域技术创新的关注，推动行业交流，促进芯片科技的良性。

半导体行业发展趋势

2023年半导体产业的发展趋势主要呈现为以下几个方面：

一 行业挑战与强劲发展动力并存

通胀压力、地缘政治不稳、库存过剩、持续的供应链中断、个人电脑和移动设备市场需求疲软，以及技术人才短缺等因素的存在，导致今年全球半导体企业收入与去年相比下降。2024年尽管依然面对其中的一些挑战，但整体行业发展动力强劲，预计收入将恢复两位数同比增长。在我们的年度调查中发现，虽然2023年全球收入减少，但83%的行业高管预计2024年公司收入将有所增长。同样，85%的行业高管认为整个行业将有所增长，这显示出预计行业收入将增长的高管数量显著增加。

当下生成式人工智能（Gen AI）、云计算和数据中心方兴未艾，汽车用半导体大幅增加，航空航天预算不断上调等多种因素的叠加，帮助行业克服了部分宏观经济和地缘政治带来的市场风险。伴随着需求不断增加抵销了供应过剩的影响，2024年将成为半导体行业展开新一轮上升周期的元年。

在我们今年的调查发现，40%的高管预计公司的收入将增长11%或以上，但2022年预计增长率高达50%。纵观整个行业，85%的高管认为行业在2024年的收入将有所增长。与2022年的调查结果相比高21%。

与今年相比，您对公司明年的收入增长有何预期？



资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

与对收入和盈利的看法相比，对资本支出的预期更接近50/50。对利率的担忧可能阻碍了部分公司对资本支出的投入。需求放缓也可能在中短期内减少对进一步提升产能的需求。考虑到美国、亚洲和欧洲的各种政府补贴计划，公司申请补贴的时间与他们实际收到资金、启动或重新启动项目的时间之间似乎存在滞后。

2022年美国通过《芯片法案》，多家公司摩拳擦掌，纷纷计划扩张。尽管这股热情并未完全消退，但似乎有所减弱，随着公司陆续提交申请和拨款申请人评估规则和合规要求，相关公司逐渐转向较现实的立场。

至于研发支出，2024年的预期略低于2023年，但仍然强劲。在今年的调查中，69%的高管预测研发支出会增加，低于2022年的75%。从地区来看，美国67%的高管预计增加研发支出，与全球平均水平持平，而欧洲只有56%的高管预计增加研发支出。亚太区公司对2024年的研发支出期望最高，84%的高管预计支出会增加，没有受访者预计会减少支出。

您对贵公司未来一年的资本支出有何预期？



资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

即使许多公司在2023年已实施裁员，仍有45%高管预计2024年员工人数将持平或减少。多年来，人才一直是半导体行业关注的焦点。行业内的职位空缺总是多于合格的应聘者。事实上，近期有一项研究预测到2030年，仅美国半导体行业将短缺6.7万名技术工人。

在未来一年，您预计贵公司的全球员工人数会增加还是减少？



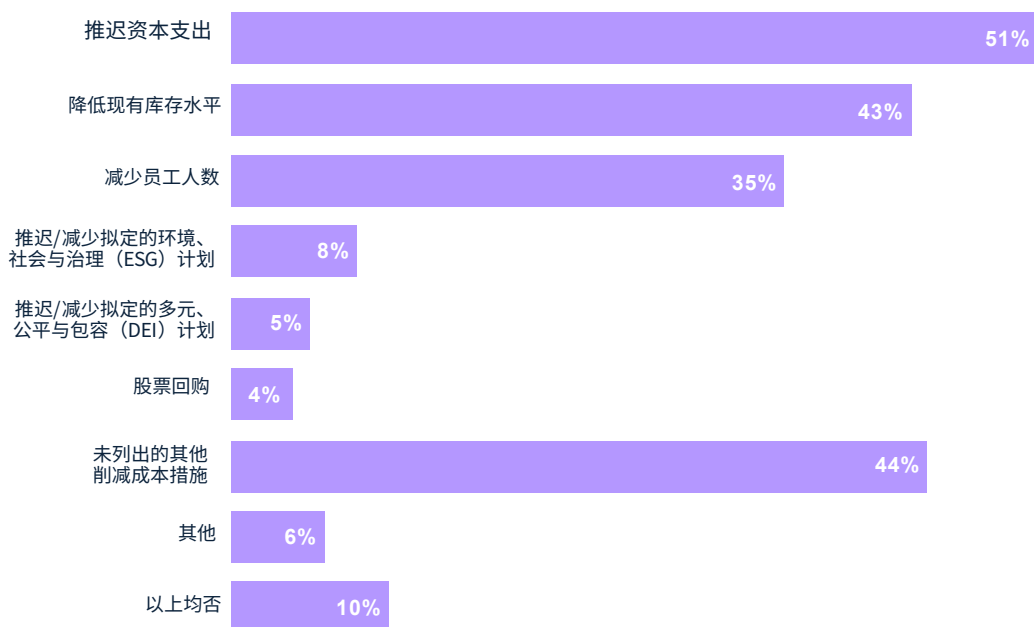
资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

二 半导体公司正在调整资本支出计划

尽管AI、高效能计算机和汽车行业对数据处理能力和速度的需求不断增长，但2024年经济放缓仍令人担忧。这些经济隐忧，加上多地政府大选等多变的地缘政治形势，可能会加剧受访者对资本支出和研发支出的悲观预期。

至于半导体公司可能会采取哪些具体行动来应对经济环境，过半数（51%）公司表示，他们已经或计划推迟资本支出。这与受访者被直接问到资本支出时的预期相近——45%的受访者预期没有变化或减少。

为了应对当前的经济环境，贵公司已经采取或预计明年将采取哪些首要行动？（最多选取3项）



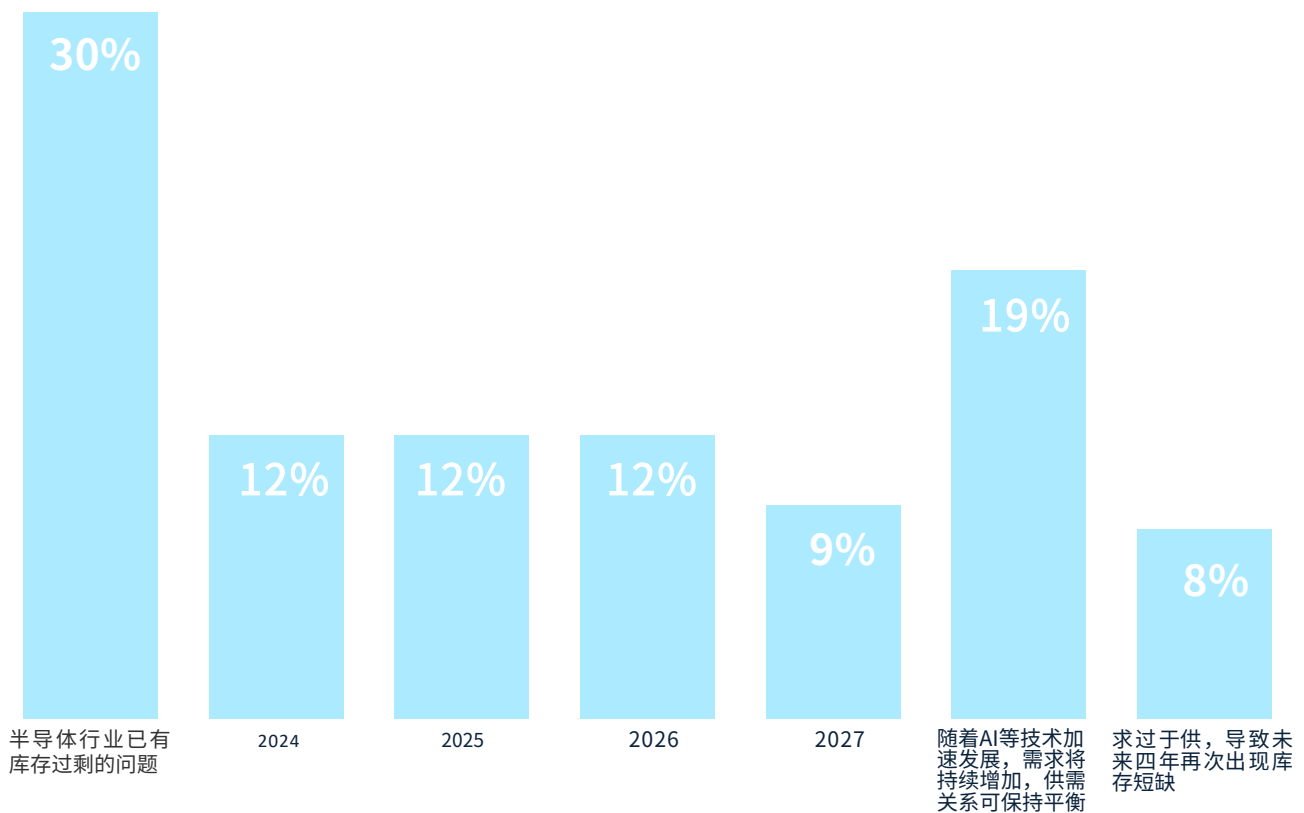
资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

三 超额供应问题已得到缓解

一年前，部分行业仍在担忧库存短缺。这种担忧已经缓解，现在人们几乎不再担心因为产品不足而失去收入。目前半导体行业高管们似乎认同行业已经巩固供应链，只有少数的高管认为未来4年将再次出现短缺。

随着芯片短缺的缓解，我们询问了行业高管对于出现供应过剩的可能性或现状的看法。去年有近四分之一的高管认为市场已有库存过剩的问题。在2023的调查中，30%的高管表示有同感，另有12%的高管认为在2024年下半年将出现库存过剩的问题。同时预计直到2025年至2027年才会再次出现过剩。

预计何时再次出现半导体库存供应过剩的情况？



资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

四 汽车再次成为未来一年最重要的收入驱动力

随着电动化、ADAS和自动化应用在汽车业进一步普及，汽车业对先进芯片和组件的需求将爆发式增长。

尽管2024年全球汽车销量的预测增长率较低，但半导体行业人员仍将汽车视为推动收入增长的最重要因素。虽然芯片短缺有所缓解，半导体企业高管对汽车行业持乐观态度，但汽车公司本身对产品供应仍有疑虑。毕马威最新公布的《全球汽车业高管调研》显示，近半数的汽车企业高管非常或极为担心未来5年半导体零部件的供应连续性。另外少部分的受访者仍表示适度担忧。这有助于解释为什么几家主要的车企正试图通过创建自身的芯片部门及与半导体企业签订长期供应协议来缓解供应链问题，以保护和确保重要的硅组件供应。

以下各项应用在推动贵公司未来一个财年的收入方面有多重要？

(平均值为1至5，1=完全不重要，5=非常重要)

	2024	2023
汽车	3.9	3.9
人工智能	3.7	3.4
物联网	3.5	3.5
云计算/数据中心	3.5	3.5
无线通信 (含5G技术和基础设施、智能手机和其他移动设备)	3.5	3.6
消费类电子产品	3.3	3.2
工业设备	3.3	3.2
个人电脑	3.0	2.7
有线通信	2.7	2.8
元宇宙	2.5	2.4

资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

五 AI 现已成为第二大最重要的收入驱动力

2023年人工智能跃升为半导体行业的第二大收入驱动行业，由于领先的AI模型大量使用GPU，增长呼应了微处理器的上升趋势。

其中，美国受访者更看好AI，将其评为2024年半导体行业中增长机会最大的行业，领先于数据中心和汽车行业。

欧洲受访者则将AI位列第四，紧随汽车、物联网和工业设备之后。最后，亚太区高管将AI位列第五，紧随汽车、无线通信、消费电子产品和云计算、数据中心之后。

根据半导体行业未来一年的增长机会，为以下各项评级

(平均值为1至5，1=完全不重要，5=非常重要)

	美国	欧洲	亚太区
汽车	3.6	4.0	4.2
人工智能	4.1	3.3	3.4
物联网	3.6	3.6	3.3
云计算/数据中心	3.7	2.9	3.5
无线通信 (含5G技术和基础设施、智能手机和其他移动设备)	3.5	3.3	3.7
工业设备	3.2	3.6	3.2
消费类电子产品	3.1	3.2	3.7
个人电脑	3.1	2.6	3.2
有线通信	2.6	2.6	3.1
元宇宙	2.5	2.4	2.6

资料来源：KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

六 微处理器成为行业内最具增长潜力的产品机会

AI应用、汽车和高效能设备对数据处理能力的要求前所未有地增加。先进驾驶辅助系统（ADAS）作为汽车半导体市场的最大细分市场。近期的企业公告显示，汽车终端市场的同比年增长率尽管将低于2023年，但汽车业对半导体组件的长期需求仍将继续增加。因此，微处理器跃居第一，成为未来一年最具增长潜力的产品。

2022年，微处理器紧随传感器、MEMS和模拟、射频、混合信号之后，位居第三。微处理器上一次是在2016年的展望中被列为最具增长潜力的产品，与传感器和存储器并列。

根据半导体行业未来一年的增长机会，为以下各项评级
(平均值为1至5, 1=最低增长机会, 5=最高增长机会)

	2024	2023
微处理器 (GPU/MCU/MPU)	3.8	3.4
传感器/MEMS	3.4	3.6
光电元件	3.3	3.3
存储器 (NAND/动态随机存储器)	3.2	2.7
模拟系统/射频/混合信号	3.1	3.5
分立器件	2.9	2.9
其他逻辑	2.9	3.0

资料来源: KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey

七 人才连续三年成为未来半导体行业面临的重大问题

芯片制造行业有能力实现许多任务的自动化，但技术工人仍供不应求。人才风险已成为该行业在2023年再次面对的首要问题。

从区域角度来看，美国人才风险已成为半导体技术国有化之后的第二大问题；人才风险与本土化之间的这种平衡，也成为美国建立新的制造设施和供应链以抵减对亚洲依赖的目标。然而，美国的人才供应前景并不乐观。亚太区的人才风险是行业的首要问题。但与同业相比，他们认为代工厂成本高和产能过剩的问题更为严重。从业人员最担心的也是人才风险，以及对本土化和全球通胀的过度反应。欧盟正不断努力并投入大量资源，吸引新的芯片公司，

并鼓励当地公司扩建或从零开始投资建设。2023年，本土化、国有化在2022年的调查中与全球通胀并列第二。2022年末，企业对全球通胀和政府可能采取的行动感到担忧，尤其是展望未来三年更是缺乏信心。

如果本土半导体生态系统的增长还不足以让人才库承受巨大压力，那么与半导体行业有着千丝万缕关系的其他企业（如平台巨头、汽车公司等）在过去几年一直建立自身的芯片设计能力令问题雪上加霜。尽管半导体行业的发展令人憧憬，但获得足够人数的技术工人是显而易见的软肋。对跨国企业来说，这是一个可以发挥自身优势的挑战。

半导体行业 政策法规更新

发布时间	文件号	名称	发布机构	网址
2024.02.08	穗工信规字〔2024〕1号	广州市关于聚焦特色工艺半导体产业高质量发展的若干措施	广州市工业和信息化局	
2023.12	工信厅科〔2023〕80号	工业和信息化部办公厅关于印发国家汽车芯片标准体系建设指南的通知	工业和信息化部办公厅	
2023.09.12	财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告2023年第44号	关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告	财政部，税务总局，国家发展改革委，工业和信息化部	
2023.01.19	苏政规〔2023〕2号	关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策	江苏省人民政府办公厅	
2023.01.03	工信部联电子〔2022〕181号	工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见	工业和信息化部，教育部，科学技术部，中国人民银行，中国银行保险监督管理委员会，国家能源局	
2022.12.30	浙经信软件〔2022〕245号	浙江省集成电路产业链标准体系建设指南（2022年版）	浙江省经济和信息化厅，市场监督管理局	
2022.10.11		深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）	深圳市发展和改革委员会	
2022.06.23	济政办发〔2022〕3号	关于促进集成电路产业发展的意见	济南市人民政府办公厅	

半导体行业 政策法规更新

发布时间	文件号	名称	发布机构	网址
2022.06.06		深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）	深圳市发展和改革委员会，科技创新委员会，工业和信息化局，国有资产监督管理委员会	
2022.03.17		广州市半导体与集成电路产业发展行动计划（2022-2024年）	广州市工业和信息化局	
2022.03.14	发改高技〔2022〕390号	关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知	发展改革委工业和信息化部 财政部海关总署税务总局	
2022.03.14		中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	十三届全国人大四次会议批准通过	
2021.03.22	财关税〔2021〕5号	关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法	财政部，发展改革委，工业和信息化部，海关总署，税务总局	
2021.01.15	工信部电子〔2021〕5号	基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）	工业和信息化部	
2020.12.11	财政部，税务总局发展改革委，工业和信息化部公告2020年第45号	关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告	财政部税务总局发展改革委 工业和信息化部	
2020.08.04	国发〔2020〕8号	国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知	国务院	
2019.10.30	国家发展和改革委员会令 第29号	产业结构调整指导目录（2019年本）	国家发展和改革委员会	

半导体行业 政策法规更新

发布时间	文件号	名称	发布机构	网址
2018.03.28	财税〔2018〕27号	关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知	财政部，国家税务总局，国家发展和改革委员会，工业和信息化部	
2018.03.28	国发〔2016〕73号	“十三五”国家信息化规划	国务院	
2016.11.29	国发〔2016〕67号	“十三五”国家战略性新兴产业发展规划	国务院	
2015.05.08	国发〔2015〕28号	中国制造2025	国务院	
2015.03.02	财税〔2015〕6号	关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知	财政部，国家税务总局，国家发展和改革委员会，工业和信息化部	
2012.04.20	财税〔2012〕27号	关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知	财政部，国家税务总局	
2011.01.28	国发〔2011〕4号	国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知	国务院	
2001.04.02	国务院令第三百号	集成电路布图设计保护条例	国务院	
2000.06.24	国发〔2000〕18号	国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知	国务院	

毕马威中国 “芯科技” 50 评选团队

李吉鸣 Jamie Li	毕马威中国 半导体行业审计主管合伙人	周琳 Lynn Zhou	毕马威中国 审计服务合伙人
张欢 Charles Zhang	毕马威中国北方区 半导体行业审计主管合伙人	邵锋 Tony Shao	毕马威中国 审计服务合伙人
陈怡 Cathy Chen	毕马威中国华南区 半导体行业审计主管合伙人	胡世达 Will Hu	毕马威中国 审计服务合伙人
方海杰 Jay Fang	毕马威中国华东及华西区 生物科技行业与消费品行业 审计主管合伙人	郑佳 Amber Zheng	毕马威中国 咨询服务合伙人
房灵 Wing Fong	毕马威中国华南区 高科技及生命科学行业 主管合伙人	章晨伟 Jesse Zhang	毕马威中国 审计服务合伙人
王威杰 Jerry Wang	毕马威中国 咨询服务合伙人	黄晓冬 Jeff Huang	毕马威中国 审计服务合伙人
刘侨敏 Josie Liu	毕马威中国 审计服务合伙人	廖雅芸 Kelly Liao	毕马威中国 税务服务合伙人
刘婧媛 Sophie Liu	毕马威中国 审计服务合伙人	谭伟 Wayne Tan	毕马威中国 税务服务合伙人
吴惠煌 Spencer Wu	毕马威中国 审计服务合伙人	黄昕 Tom Huang	毕马威中国 审计服务合伙人
吕欣潔 Jelena Lu	毕马威中国 审计服务合伙人	李涤非 Aaron Li	毕马威中国 税务服务合伙人
李艳艳 Vicky Li	毕马威中国 审计服务合伙人		

毕马威 半导体行业洞察

The timeline consists of a central horizontal line with circular nodes at the top and bottom. Each node is connected to a specific report or publication. The reports are arranged in a staggered fashion, alternating between the top and bottom of the timeline. Each report includes a thumbnail image, a QR code, and a caption with the title and date.

- 中国“芯科技”新锐企业50报告 (第四届)**
2023年 11月
- 中国“芯科技”新锐企业50报告 (第三届)**
2022年 11月
- 毕马威中国半导体行业关键服务产品手册**
2022年 11月
- 毕马威中国半导体行业产品服务Talkbook**
2022年 11月
- 2023年 全球半导体行业展望**
2022年 10月
- 中美贸易摩擦背景下供应链转型升级白皮书**
2022年 9月
- 中国“芯科技”新锐企业50报告 (第二届)**
2021年 11月
- 五部委联合发布集成电路企业或项目、软件企业清单管理程序、条件和标准**
2021年 04月
- “十四五”规划行业影响展望——科技篇**
2021年 02月
- 中国“芯科技”新锐企业50报告 (第一届)**
2020年 11月

联系我们



李吉鸣

Jamie Li

毕马威中国

半导体行业审计主管合伙人

+86 (21) 2212 2558

jamie.li@kpmg.com



张欢

Charles Zhang

毕马威中国北方区

半导体行业审计主管合伙人

+86 (10) 8508 7305

charles.h.zhang@kpmg.com



陈怡

Cathy Chen

毕马威中国华南区

半导体行业审计主管合伙人

+86 (20) 3813 7906

cathy.y.chen@kpmg.com



毕马威

kpmg.com/CN/socialmedia



如需获取毕马威中国各办公室信息，请扫描二维码或登陆我们的网站：
<https://home.kpmg/cn/zh/home/about/offices.html>

所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。

© 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

毕马威的名称和标识均为毕马威全球组织中的独立成员所经许可后使用的商标。